

◆最近の主な投資内容

金属基板では、長野県駒ヶ根の主力工場の能力増強をするとともに、約2万㎡隣接地を取得し次の飛躍にも備えている。マレーシアにも新生産棟を数十億円かけて作る予定である。半導体プロセス部品では、宮田工場に設備を順次増やし、2024年4月に増築も行う。モーターコアでは、厚木工場の生産棟の増築や50億円をかけて新生産棟を建設し設備増強を続けていく。メキシコでは、既存工場の隣接地3万8千㎡を取得し、将来にキャパシティアップに備えている。これらの3つの事業は、今後ニッパツを支える主要事業として積極的に投資を進めていく。

◆金属基板

金属基板とは放熱性の高い基板であり、ベースにアルミや銅などの金属板、その上に絶縁層高放熱樹脂、アルミナ、窒化アルミ、窒化ケイ素の高放熱のセラミック粉末を混ぜて更に熱伝導率を高めた絶縁層を介した上に回路を形成しているものである。非常に効率よくヒートシンクとヒートスプレッターの役割を果たしており、広く民生用、産業用、車載用に使用されている。重要なポイントは厚銅回路が作れることであり、大電力を流すパワー半導体は電力が大きく、回路の厚さが必要になる。当社は0.5mmから2.0ミリ程度の厚さの回路が形成でき、且つ高精度である。樹脂基板やガラエポ基板は厚くできないため、今後のパワー半導体に対しては有効な基板と考えている。現在の用途では車載用が増えており、売上の7割が車載用である。産業用もパワー半導体が増えていくので、こちらも伸ばしていくことを考えている。民生用は、エアコンやLEDに使用されている。産業用はほぼパワートランジスタであり、それらは太陽光発電所のインバータやロボットのDCDCコンバータなどの電力変換装置に使用されている。車載用では、LEDヘッドランプ、色々なコンバータ、メーターパネルやヘッドアップディスプレイなど熱の集中度が高いところに使用されている。本命はEV車のモーター制御に使用されるパワーコントロールユニット向けであり、開発と投資を行っている。売上は駒ヶ根工場、マレーシア工場の能力増強を続け、駒ヶ根工場の新生産棟を建設することで、2030年の売上は現在の5倍の300億円を目指している。

◆半導体プロセス部品

これまでは、エッチング装置に使用される冷却板、CVD、ALDの成膜装置に使用されるヒータを説明してきたが、最近はプロセスガスを流すシャワーヘッドが開発段階から量産開始段階となっている。より均一にガスを流すこと、複数のガスを流すこと、温度コントロールができることなどの複雑なスペックが求められるようになり、当社の得意とする製品が求められるようになってきている。本格的には2023年後半から生産される予定である。半導体製造装置の市場は2022年下期と2023年上期は低迷しそうであるが、当社は新商品が伸びるため、緩やかな低迷となり、それ以降は増えていく予定である。

◆モーターコア

従来から行っている通り3極体制を構築していく。2010年に厚木工場で生産を開始し、2013年米国で生産開始、その後2016年にメキシコに移管。2021年には中国に工場を建設した。自動車部品では珍しく、キャパシティーがないと受注が見込めない製品であり、これらの拠点はさらに増設しながらスピード感のある投資と受注のバランスを取っていく。日本の能力増強、中国の能力増強、その後はメキシコの生産棟建設含めて順次能力増強をしながら、将来は300億円以上の売上を目指している。

以上をメインの事業として推進していくが、この他にHDDサスペンションの売上も伸ばし、グループ会社のレジュー用品も伸ばしていく。自動車生産台数は半導体不足の影響で苦しいところはあるが、これらの製品が補い、その間に自動車の立て直しを図り、全体的に伸ばしていこうと考えている。

以上